

令和8年度 第61回グラインディング・アカデミー 研磨加工の基礎—基礎から最新技術まで— 開催報告

【(公社)砥粒加工学会 企画委員会】

1. はじめに

令和8年6月11日(木)、第61回グラインディング・アカデミー「研磨加工の基礎—基礎から最新技術まで—」を立命館東京キャンパスにて開催しました。研磨加工の研究および技術開発に携わる2名の講師をお招きし、基礎から応用まで幅広く学べるプログラムを企画しました。当日は企業技術者・研究者ら51名が参加し、有意義な講義を聴講のうえ盛況のうちに終了しました。

2. 講習会の内容

冒頭で企画委員長の磯部 浩巳先生(長岡技術科学大学)が挨拶し、企画の意図を説明しました。

続いて、九州大学・埼玉大学名誉教授/株式会社 Doi Laboratory の土肥 俊郎先生より「研磨加工/CMP 技術の基礎と応用」と題した4部構成の講義をいただきました(図1)。

- 第1部 研磨の原点から先端的半導体デバイスを支える超精密研磨/CMP 技術
- 第2部 超精密研磨/CMP の加工メカニズムとポイント
- 第3部 超精密平坦化 CMP の基本技術と次世代 3D デバイス(後工程)への応用
- 第4部 超難加工・化合物半導体/ダイヤモンド基板の加工プロセス/Beyond the CMP 技術

いずれの講義も動画を交えながら丁寧に解説いただき、長年同分野に携わってこられたご経験をもとに歴史から最新技術まで説明いただきました。

次に、株式会社ジェイテックコーポレーションの田中 智之様より「ECMP による SiC ウェハ加工の高速化と実用化開発」についてご講演いただきました。現行 SiC 研磨の課題を明確にしたうえで、次世代手法として電気化学援用酸化を適用した ECMP の検討成果を詳細にご紹介いただきました(図2)。

両講演とも質疑応答が活発に行われ、終了後も講演者の周囲には質問や名刺交換に訪れる参加者が絶えず、対面開催ならではの交流の場となりました。

3. おわりに

グラインディング・アカデミーでは、砥粒加工学会の根幹となる分野に関する基礎講座を企画し、学び直したい技術者、新入社員、大学院の学生の最新技術の紹介も行っています。毎回、充実した内容の講義が行われ、大変有益な講座になっています。今回のアカデミーでは、初学者にも分かりやすい研磨加工の基礎から、有識者による将来展望

まで学ぶことができ、大変有意義な機会となりました。今後もグラインディング・アカデミーへの積極的なご参加をお願い申し上げます。第62回 グラインディング・アカデミーでは、今回の内容をオンラインにて受講することができます。都合がつかずに参加できなかった方は、第62回グラインディング・アカデミーに奮ってご参加ください。最後に、今回の講習会において貴重なご講義をいただいた講師の先生方に、厚くお礼申し上げます。

(文責:企画委員 北村 雄春, 株式会社ネオス)

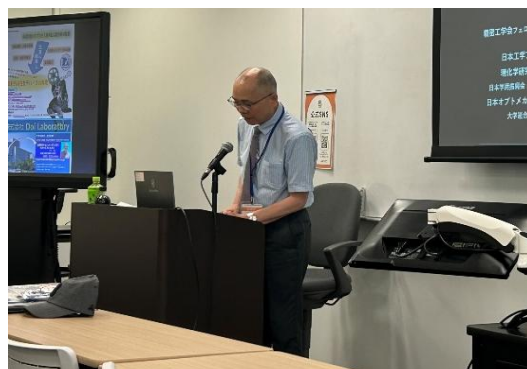


図1 九州大学・埼玉大学名誉教授
株式会社 Doi Laboratory
土肥 俊郎 先生



図2 株式会社ジェイテックコーポレーション
田中 智之 様